



**ADVANTEST**<sup>®</sup>

# 2021年度（2022年3月期） 第2四半期決算説明会

2021年10月28日  
株式会社アドバンテスト

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

# ご注意

---

## 会計基準について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しています。

## 将来の事象に係る記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

## 本資料の利用について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用（改変、複製、転用等）することを禁止します。



## 2021年度第2四半期決算報告

取締役 兼 経営執行役員  
CFO & CCO (Chief Financial Officer & Chief Compliance Officer)  
管理本部長 藤田 敦司

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

**ADVANTEST**<sup>®</sup>

## 四半期業績推移

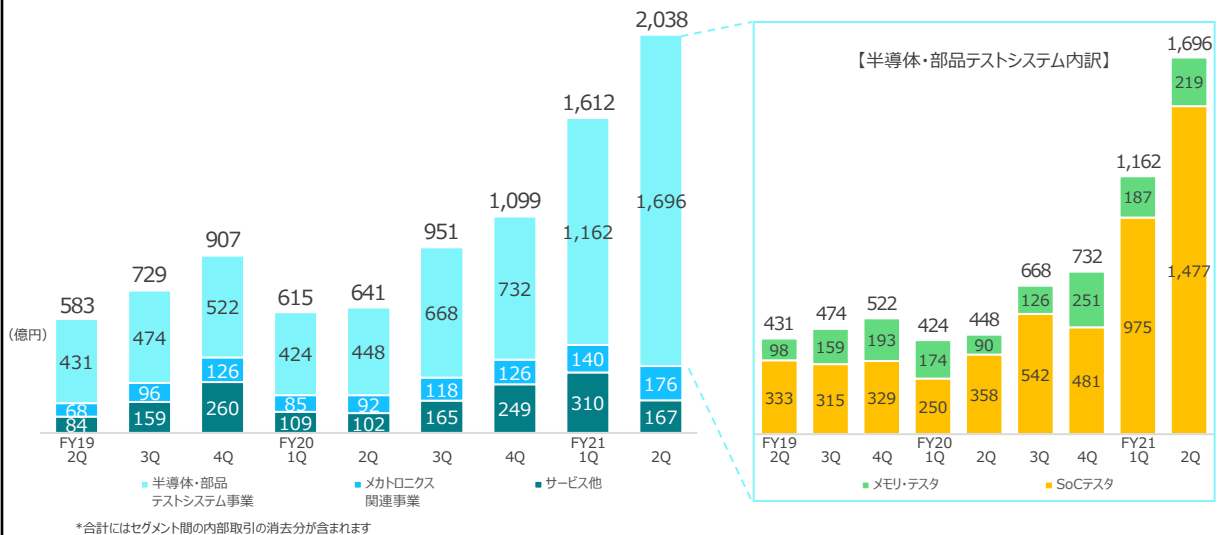
(億円)

	FY20				FY21						
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q		前期比		前年同期比	
						予想	実績	増減額	増減率	増減額	増減率
受注高	615	641	951	1,099	1,612	988	2,038	+426	+26.4%	+1,396	+3.2倍
売上高	667	774	781	906	971	939	909	-62	-6.4%	+135	+17.4%
売上総利益	380	416	402	485	547	-	501	-47	-8.7%	+83	+20.0%
売上総利益率	56.9%	53.9%	51.5%	53.5%	56.4%	-	55.0%	-1.4pts		+1.1pts	
営業利益	135	174	153	245	261	235	214	-48	-18.3%	+39	+22.2%
営業利益率	20.2%	22.6%	19.5%	27.1%	26.9%	25.0%	23.5%	-3.4pts		+0.9pts	
税引前四半期利益	129	164	139	264	257	235	216	-42	-16.4%	+51	+31.0%
四半期利益	106	139	120	333	193	176	159	-34	-17.8%	+20	+14.1%
四半期利益率	15.8%	18.0%	15.4%	36.7%	19.9%	18.7%	17.5%	-2.4pts		-0.5pts	
受注残	857	725	895	1,088	1,729	1,778	2,858	+1,129	+65.3%	+2,134	+3.9倍
為替レート	1米ドル	108円	107円	105円	104円	109円	110円	110円	1円 円安	3円 円安	
	1ユーロ	118円	123円	124円	127円	131円	135円	131円	-	8円 円安	

### ○ 2021年度第2四半期の業績概要

- 3ヵ月前の業績予想を振り返りますと、1Qに受注が急拡大したこともあり、2Q受注は1Q比減少すると見込んでいました。
- しかし、半導体の高性能化、複雑化の進展が継続する中で、今後のテスト能力拡張の必要性が業界において高まったことから、先端プロセス品中心に、顧客のテスト投資意欲は一段と引きあがりました。
- また世界的な半導体不足が継続していることから、成熟プロセスで製造される多様な半導体に対しても、生産能力増強に向けた受注が活発でした。
- その結果、2Q受注は大幅に伸長しました。
- 売上については、コロナ禍による物流ひっ迫の影響等を受け、7月時点の2Q予想を30億円下回りました。
- 受注、売上、利益の詳細は、次以降のスライドで順次ご説明いたします。

## 四半期受注高 事業セグメント別



### ○ 2021年度第2四半期の受注高

- 良好な事業環境が継続していることで、4四半期連続の四半期受注記録の更新となりました。2Q受注は、2017年度の通期売上高に匹敵する水準となります。

### ○ 半導体・部品テストシステム事業

- 前期比 46.0%増 1,696億円
- SoCテストは、前期比502億円増の1,477億円と、受注が一段と伸長しました。特にスマートフォンの基幹部品であるアプリケーション・プロセッサ (APU)や、ハイ・パフォーマンス・コンピューティング (HPC)用デバイスなど、ハイエンド SoC向けが受注を力強く牽引しました。加えて自動車、産業機器、民生機器向けの成熟プロセス品の引き合いも好調でした。
- メモリ・テストは、前期比32億円増の219億円でした。高水準なDRAM向けに加え、フラッシュメモリ向けでの受注が伸びました。

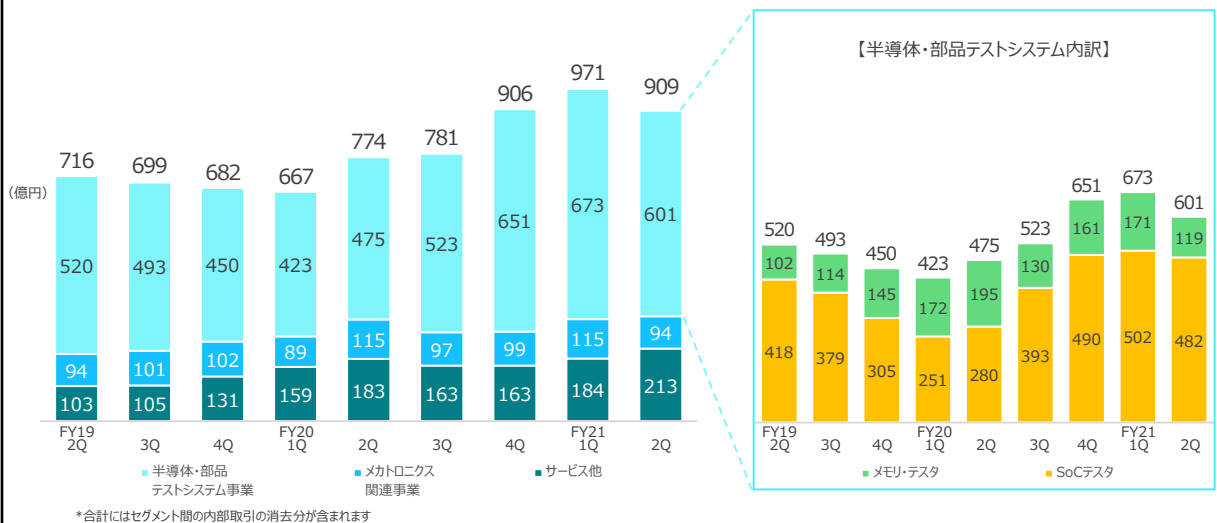
### ○ メカトロニクス関連事業

- 前期比25.3%増 176億円
- テスタの引き合いが活況の中、デバイス・インタフェース、テスト・ハンドラも好調でした。またEUV関連のナノテクノロジー製品の受注も増加しました。

### ○ サービス他

- 前期比 46.4%減 167億円
- システムレベルテストで1Qのまとまった受注からの反動減がありました。

## 四半期売上高 事業セグメント別



### ○ 2021年度第2四半期の売上高

- 半導体テスト需要の拡大に、システムレベルテスト事業の成長が加わり、900億円台の高水準な売上高が続きました。

### ○ 半導体・部品テストシステム事業

- 前期比 10.8%減 601億円
- 内訳としては、SoCテストが482億円、メモリ・テストは119億円です。
- SoCテストで、物流面の混乱から一部納入できない製品がありました。メモリ・テストも前期比減少していますが、こちらはほぼ想定通りの推移です。

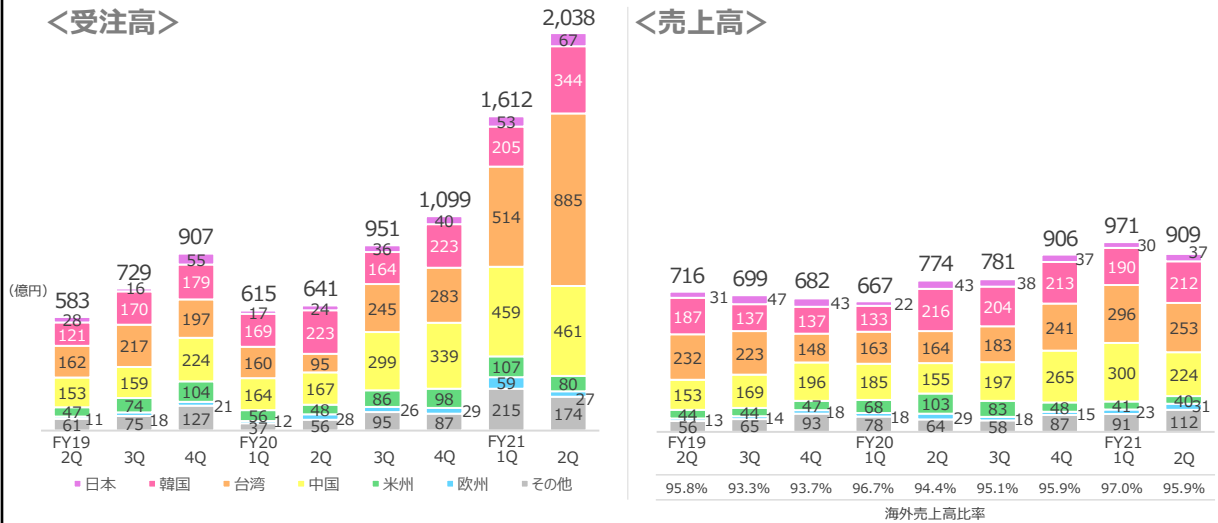
### ○ メカトロニクス関連事業

- 前期比 17.3%減 94億円
- メモリ・テストの販売減に連動して、テスト・ハンドラやデバイス・インタフェースの売上が減少しました。

### ○ サービス他

- 前期比 16.5%増 213億円
- ハイエンドSoC向けを中心に、システムレベルテストの売上が着実に伸長しました。

## 四半期受注高/売上高 地域(出荷先)別



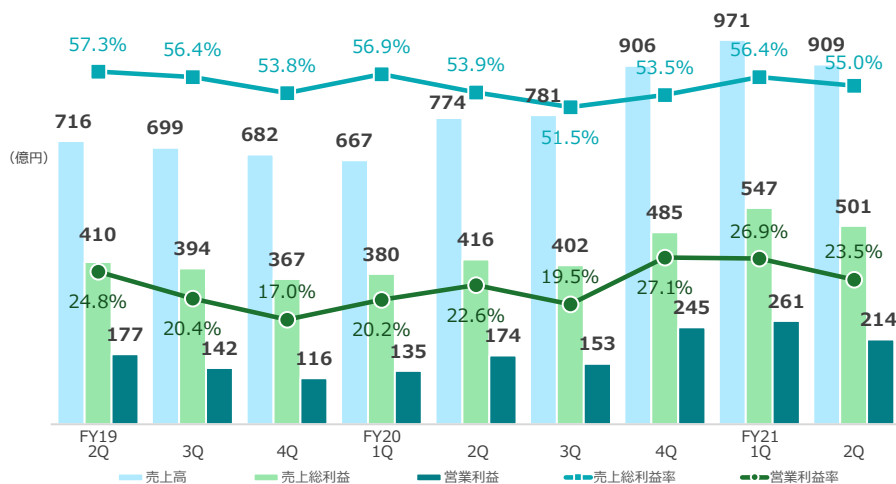
### ○ 2021年度第2四半期の地域別受注高

- 台湾  
1Qに引き続き、スマートフォンやHPC関連を中心に、ハイエンドSoC向けの受注が大きく伸びました。
- 中国  
1Q同様、顧客の旺盛な投資意欲を背景に、SoCテスト、メモリ・テスト共に高水準な受注が継続しました。
- 韓国  
スマートフォン関連のさまざまな半導体に関する商談が活発でした。

### ○ 2021年度第2四半期の地域別売上高

- 物流などの一時的な要因による期ずれを除き、おおむね想定通りの地域別構成で着地しました。
- 受注の急増を受けて、当社のサプライチェーンが完全には追従できていない面もあり、これが当社の現状の最大の課題です。

## 売上高/売上総利益/営業利益



### ○ 2021年度第2四半期の営業利益

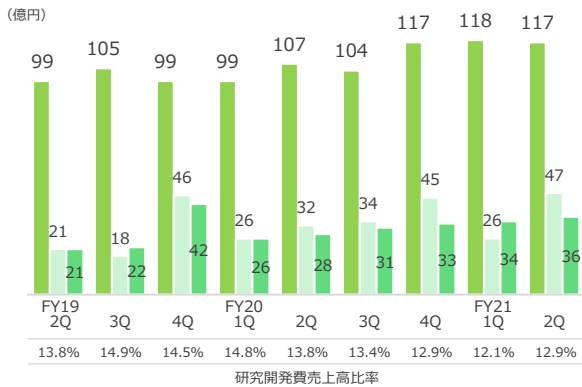
- 売上総利益率 55.0%  
7月の業績予想に比べ、売上高は下回りましたが、売上総利益率はおおむね想定通りで着地しました。
- 販管費等（その他収益・費用を合算） 287億円
- 営業利益 214億円
- 営業利益率 23.5%



# 投資等/キャッシュ・フロー

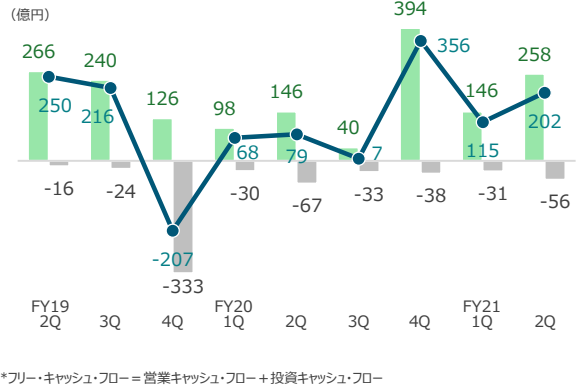
## <投資等>

- 研究開発費
- 設備投資
- 減価償却費



## <キャッシュ・フロー>

- 営業キャッシュ・フロー
- 投資キャッシュ・フロー
- フリー・キャッシュ・フロー



### ○ 2021年度第2四半期の研究開発費等

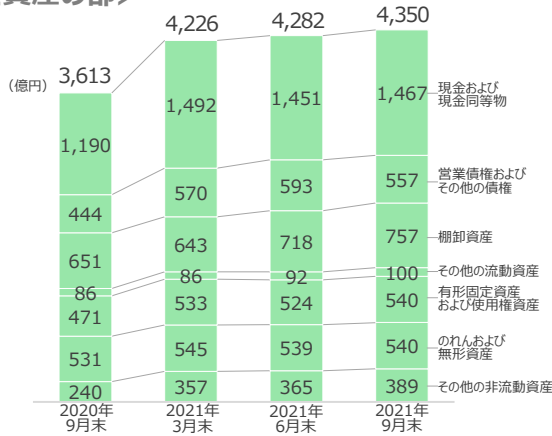
- 研究開発費 117億円
- 研究開発費売上高比率 12.9%
- 設備投資 47億円  
システムレベルテストのビジネスが好調であり、さらなる需要増加に追随すべく、米国で生産能力拡張に着手しました。
- 減価償却費 36億円

### ○ 2021年度第2四半期のキャッシュ・フローの状況

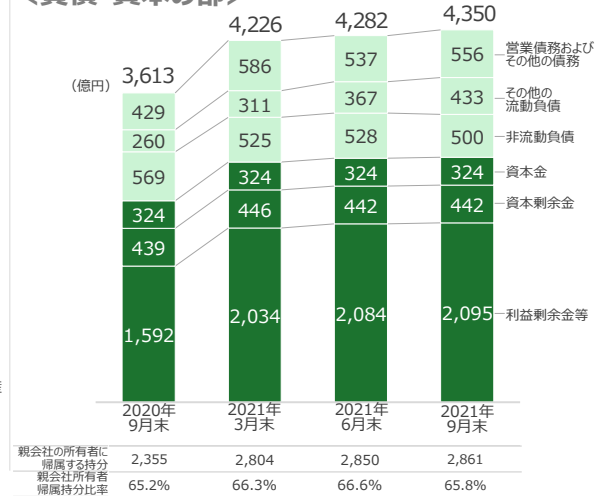
- フリー・キャッシュ・フロー 202億円

# 連結財政状態

## <資産の部>



## <負債・資本の部>



### ○ 2021年9月末時点のバランス・シート

- 総資産 4,350億円
- 現金および現金同等物 1,467億円
- 親会社の所有者に帰属する持分 2,861億円
- 親会社所有者帰属持分比率 前期比0.8ポイント減 65.8%
- 7月に発表した自社株買いの進捗については適時開示しているとおりですが、9月末までに取得した自己株式は180万株、178億円です。上限1,000万株に対しての進捗は18%、上限700億円に対しての進捗は25%です。



## 2021年度事業見通し

代表取締役 兼 執行役員社長（CEO）  
吉田 芳明

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

**ADVANTEST**<sup>®</sup>

## 半導体テスト市場の動向 <21年10月時点の見方>

### CY21予想

半導体高性能化に向けた積極投資の進展と活発な生産能力増強投資を受け、全体として約\$5.5Bを見込む（YoY+30%）

-SoCテスト市場規模：約\$4.1Bに引き上げ

- ・ハイエンドSoC向けなど、先端プロセス周辺のテスト能力拡充投資が市場を力強く拡大
- ・加えて、成熟プロセスを採用する多様な半導体に対する積極的な能力増強投資が進展

-メモリ・テスト市場規模：約\$1.4B（前回7月予想から変更なし）

- ・微細化、多層化、高速化/広帯域化などのデバイス進化が、テスト需要を持続的に牽引中

	CY20実績	CY21推定
SoCテスト市場	約\$3.0B	約\$4.1B (7月時点推定:約\$3.8B)
メモリ・テスト市場	約\$1.2B	約\$1.4B (7月時点推定:約\$1.4B)

Source: Advantest

### ○ 暦年2021年のテスト市場の見方

- ・ 2021年は、最終需要の拡大と最終製品の高性能化に沿う形で、半導体不足を解消するための生産能力増強や半導体高性能化への積極投資が継続しています。
- ・ 2021年の半導体テスト市場は約5.5B米ドルと、前年比およそ30%の成長となると見込んでいます。
- ・ 2021年のSoCテスト市場については、主に先端プロセス向けの需要の伸びを反映し、約300M米ドル引き上げます。その結果、前年比約37%の成長となる、およそ4.1B米ドルと推定しています。
- ・ メモリ・テスト市場では、前回の見通しを据え置き、前年比約17%の成長となるおよそ1.4B米ドルを見込んでいます。
- ・ 2022年の市場予測については、まだはっきりとした数字をお出しできるような確度はありませんが、目下の深刻な半導体不足が急速に解消するという感触はなく、半導体に対する旺盛な需要はまだまだ継続するのではないかと考えています。
- ・ また2Qの大きな受注の原動力である半導体高性能化に関しても、さらなる微細化を背景に、今後も継続的な需要が期待できます。
- ・ 以上から、テスト需要の急激な落ち込みはなく、当面は良好な市場環境が継続するのではないかと考えています。
- ・ なお、当社テストも多数の半導体を使いますので、当面半導体不足の継続が見込まれる中、調達サイドの努力が一層重要な局面と考えています。

## FY21業績予想

(億円)

	FY20	FY21						前年度比		(参考)新旧予想比較	
	実績	1Q実績	2Q実績	上期実績	下期予想	通期予想	増減額	増減率	7月時点 FY21予想	修正額	
受注高	3,306	1,612	2,038	3,650	2,000	5,650	+2,344	+70.9%	4,000	+1,650	
売上高*1	3,128	971	909	1,880	2,120	4,000	+872	+27.9%	3,850	+150	
営業利益	707	261	214	475	575	1,050	+343	+48.5%	1,000	+50	
営業利益率	22.6%	26.9%	23.5%	25.3%	27.1%	26.3%	+3.7pts		26.0%	+0.3pts	
税引前利益	696	257	216	473	577	1,050	+354	+50.8%	1,000	+50	
当期利益	698	193	159	352	436	788	+90	+12.8%	750	+38	
当期利益率	22.3%	19.9%	17.5%	18.7%	20.5%	19.7%	-2.6pts		19.5%	+0.2pts	
受注残	1,088	1,729	2,858	2,858	2,738	2,738	+1,650	+2.5倍	1,238	+1,500	
研究開発費	427	118	117	235	245	480	+53	+12.4%	470	+10	
設備投資	137	26	47	73	167	240	+103	+75.2%	150	+90	
減価償却費	118	34	36	70	75	145	+27	+22.9%	135	+10	
為替レート*2	1米ドル 1ユーロ	106円 123円	109円 131円	110円 131円	110円 135円	110円 133円	4円 円安 10円 円安		110円 134円	- 1円 円高	

\*1:合計にはセグメント間の内部取引の消去分が含まれます

\*2:為替レート変動が今年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、対米ドルが1円安時+10億円です。対ユーロは-1.5億円です

13 | ADVANTEST

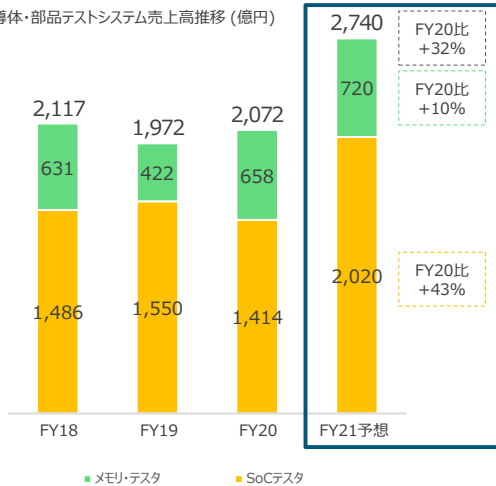
All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

### ○ 2021年度の業績予想

- 上期実績と今後の見通しを踏まえ、通期予想を、受注高5,650億円、売上高4,000億円、営業利益1,050億円、税引前利益1,050億円、当期利益788億円に引き上げます。
- 受注高は上期の急峻な受注増の反動を今後見込みます。しかしながら、半導体高性能化に伴って、現在、半導体試験に関する需要そのものの水準が切り上がっている局面にあります。そのため下期も一定の水準が継続すると予想しています。
- 旺盛な需要に対する機会損失を生じさせないよう、必要部材の確保に最大限取り組み、売上高、当期利益ともに2年連続の年度最高記録の更新を目指します。
- 売上総利益率は、通期で55-56%程度を想定しています。下期は部材コスト上昇の影響を織り込んでいますが、55%を維持できる見込みです。
- 下期の予想の前提とした為替レートは、米ドル110円、ユーロが135円です。
- 為替レート変動が今年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、対米ドルが1円安時+10億円です。対ユーロは-1.5億円です。

## FY21見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム売上高推移（億円）



### 半導体・部品テストシステム事業

#### <SoCテスト>（7月予想比 +80億円）

- APUやHPCなどの先端プロセス品における需要の伸びがFY21の業績を牽引
- 自動車向けや産業機器・民生関連なども顧客の旺盛な追加投資が継続

#### <メモリ・テスト>（7月予想比 +30億円）

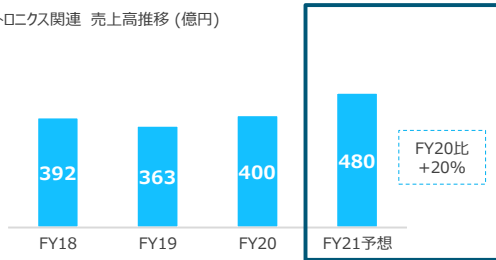
- DRAM高速試験向けの好調に加え、不揮発性メモリ向けの需要が好転

### ○ 半導体・部品テストシステム事業の今期見通し

- SoCテストの2021年度通期売上予想を、7月の見通しから80億円引き上げ、2,020億円とします。
- APU、HPCなど、微細化に伴う回路複雑化を背景としたテスト需要の力強さが想定通り継続しています。
- 加えて、世界的な半導体不足を背景に、自動車や産業機器・民生関連などで追加的なテスト需要の継続を見込んでいます。
- メモリ・テストの2021年度通期売上予想は、7月の見通しから30億円引き上げ、720億円とします。
- 当社が強みを持つDRAM高速試験向けに加え、不揮発性メモリ向け需要も想定を上回ってきています。

## FY21見通し（事業別）

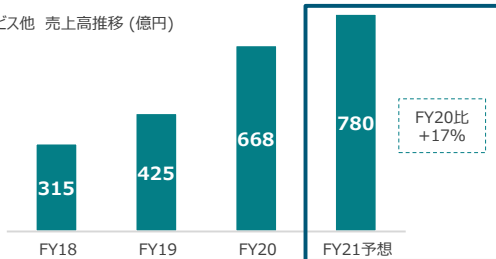
メカトロニクス関連 売上高推移（億円）



### メカトロニクス関連事業（7月予想から変更なし）

- テスタ需要と連動し、同製品向けのデバイス・インタフェースやテスト・ハンドラの需要が堅調
- EUV露光の普及を受け、ナノテクノロジー製品の販売も順調

サービス他 売上高推移（億円）



### サービス他事業（7月予想比 +40億円）

- システムレベルテスト製品需要が堅調に拡大
- 当社製品の設置台数の着実な伸びを背景に、保守サービスも順調

### ○ メカトロニクス関連、サービス他事業の今期見通し

- ・ メカトロニクス関連事業については480億円と売上予想を据え置きます。
- ・ テスタ事業と連動性の高いデバイス・インタフェースやテスト・ハンドラの堅調な需要を見込んでいます。またEUV技術の広がりを背景にナノテクノロジー製品の販売も順調です。
- ・ サービス他事業については、売上予想を40億円引き上げ、780億円とします。
- ・ システムレベルテスト事業の需要増と、半導体テスタの設置台数拡大に連動したサービス事業の伸びを踏まえたものです。

## 中長期成長に向けた取り組み

### 「グランドデザイン」(中長期経営方針 FY18-27)

<ビジョン・ステートメント>

「**進化する半導体バリューチェーンで顧客価値を追求**」

<目標>

「**売上高4,000億円以上の早期達成**」

### 第2期中期経営計画(FY21-23)

下記2軸を追求し、持続的成長に向けた基盤を強化

- ① **当社の強みを活かして既存事業を拡大**
- ② **中長期テーマである新規事業の育成**

	FY21-23平均
売上高	3,500-3,800億円
営業利益率	23-25%
当期利益	620-700億円
ROE	20%以上
1株当たり当期利益(EPS)	320-370円

### 第2期中期経営計画における成長投資

<M&A等の戦略投資: 1,000億円>

- ✓ End-to-Endのテストソリューション事業強化につながる領域でシナジーを見込める良好な案件を探索
- ✓ 新事業立ち上げなど、中長期視座の取り組みも実施

<研究開発投資: 1,500億円>

- ✓ 価値創造と社会貢献実現の原動力として、高い水準を維持

<設備投資: 400億円>

- ✓ 成長基盤強化に向けた開発力、生産力、業務効率向上用途、および社員のエンゲージメント向上のための投資

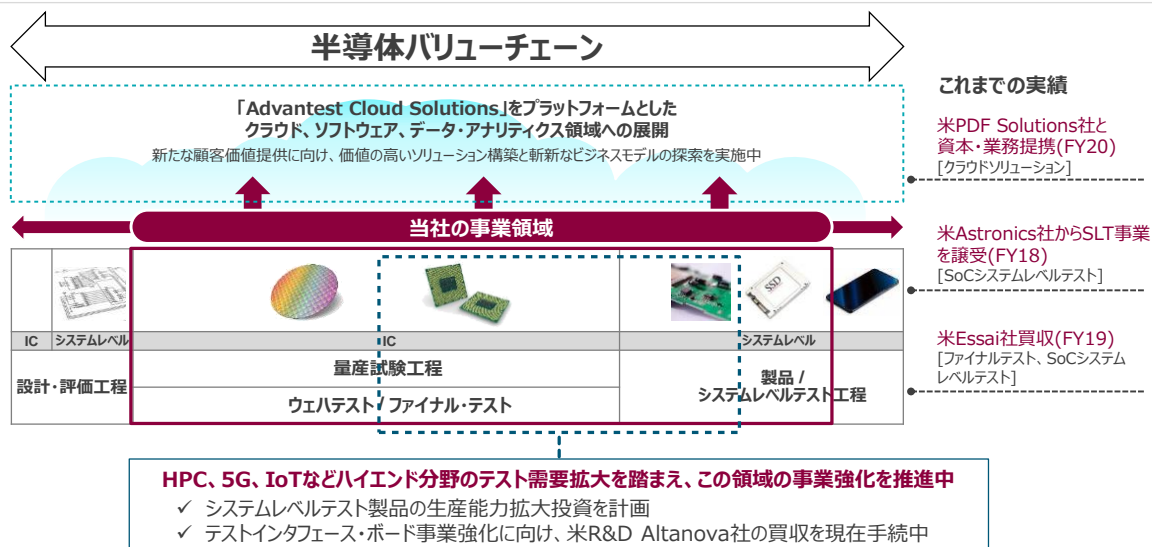
**上記に則り、FY21も積極投資を実施**

### ○ 中長期成長に向けた取り組み

- 当社は、2018年4月に策定した10年間の中長期経営方針に沿って、成長戦略を進めています。
- 今年5月に策定した第2期中期経営計画でも、成長実現のため、積極的な成長投資の実施を推進することを明記しました。
- 第2期中計初年度となるFY21も、積極投資を実施していきます。
- 中計1年目ではありますが、想定以上の需要拡大となっています。売上高4,000億円の早期達成を目標に掲げていますが、場合によっては中計目標の見直しが必要となるかもしれません。



## グランドデザインに基づく事業拡大・強化の取り組み



### ○ 中長期の事業拡大・強化の取り組みについて

- 中長期の成長に向けては、研究開発投資、設備投資に加えて、M&Aやパートナーリングといった手段も活用しながら、当社のコアビジネスの強化やコアビジネス周辺分野の開拓を行っています。
- FY21においては、現在2つの成長投資を進めています。
- 1つは設備投資です。システムレベルテスト事業分野において、米国内で計画されている大手顧客の増産体制に定めるため、米アリゾナ州において生産能力の拡大を予定しています。
- 2つ目は、一昨日にプレスリリースをしました、米R&D Altanova社の買収です。
- HPC、5G、IoTなどの分野では、今後ますます半導体の需要拡大や高性能化が期待されます。同時に、それらハイエンド分野で使われる半導体では、高精度なテストが不可欠となっていく流れにあります。
- そうした観点から、当社の顧客をサポートするために事業基盤をさらに強化することを狙いとしたものです。

# 米R&D Altanova社の買収について

## 概要

- R&D Altanova社は、米国ニュージャージー州に本社を置く、テスト用インタフェースボードのリーディングサプライヤー（非上場）
- 関係国当局の承認取得等、一般的なクロージング条件を満たすことにより成立。2021年内の完了見込み
- 現時点ではFY21に対する業績影響は軽微な見込み



## 戦略的意義

- 同社の持つ高いエンジニアリング能力・製造能力、優良顧客基盤は、当社事業と高い相互補完性。テストからデバイス端までのトータルテストソリューションを拡充
- HPCなどの成長分野において、顧客ニーズへの対応力強化を通じ当社プレゼンスを向上
- リカーリングビジネス強化。収益基盤の多様化・安定化に寄与



今後のハイエンド半導体テストに不可欠なハイクオリティEnd-to-Endソリューションを、一気通貫に提供

## ○ R&D Altanova社の買収について

- R&D Altanova社は、テストと半導体デバイスを接続するためのインタフェースボードのリーディング・サプライヤーです。
- 順調に関係当局の承認が進めば、年内にクロージングを完了できると見込んでいます。
- 同社の高いエンジニアリング能力・製造能力、優良顧客基盤、優れた技術チームは、当社事業と高い相互補完性があります。
- 当社のグローバルなフットプリントやグローバル顧客基盤を活用することで、このビジネスを加速することができると考えています。
- また彼らの製品と当社のソリューションを組み合わせることで、HPCなど今後の成長分野における顧客ニーズに応え、当社のプレゼンスをさらに強化できると考えています。
- インタフェースボードはテストソケット同様、デバイスごとに必要となる消耗品であり、リカーリングビジネスの強化を通じて収益基盤の多様化・安定化にも寄与します。

## サマリー

- 半導体市場の拡大基調が続き、試験装置に対する高水準の投資が継続
- 事業拡大施策を着実に実行、収益基盤の多様化を推進
- 部材調達の安定化と生産能力の増強で、顧客の旺盛な需要へ対応
- 引き続き以下のリスクに留意しつつ、中計目標の達成に邁進
  - ① サプライチェーンの目詰まりによる部材調達難、物流の逼迫
  - ② 期待される世界経済回復の遅れによる需要減退
  - ③ 米中対立や経済安全保障政策がもたらす半導体産業への影響

### ○ サマリー

- 足元積極的に行われている半導体不足の解消に向けた投資、および半導体の高性能化に向けた投資は当面継続されると考えています。
- 急激にテスト需要が落ち込むような心配はなく、安定的かつ良好な市場環境が続くと見込んでいます。
- そうした中、設備投資やM&Aを通じてコアビジネスの強化やコアビジネス周辺分野の開拓といった、事業拡大施策を着実に実行し、収益基盤の多様化を進めていきます。
- また、顧客の旺盛な需要に応えるために、部材調達の安定化と生産能力の増強にも取り組みます。
- 最後に、需要好調ではありますが、
  - ① サプライチェーンの目詰まりによる部材調達難や、物流の逼迫
  - ② 期待される世界経済の回復の遅れによる需要減少懸念
  - ③ 米中対立や経済安全保障政策がもたらす半導体産業への影響などといったリスクに十分留意しつつ、中計目標の達成に邁進してまいります。
- 私からの説明は以上です。
- 最後にESG・外部評価関連トピックスを次ページに掲載しているので、後でご覧いただきたいと存じます。

## ESG・外部評価関連トピックス (2021年4月～10月)

### 群馬工場の使用電力を再エネ由来100%に切り替え完了

- 米国、欧州の子会社のRE100を達成済(FY20末時点)
- グループ全体の再生可能エネルギー導入率はFY21末に50%となる見込み



### 半導体製造装置メーカーを対象とするVLSIresearch社の顧客満足度調査において、2年連続で第1位を獲得



### 「ESG推進基本方針」と「ESG行動計画2021」を策定

- 第2期中期経営計画のもと、全社のESG施策の展開を加速



### 統合報告書2021を発行

- 気候変動関連を中心にサステナビリティ開示を強化 [\(リンク\)](#)

